

ピエゾドライビングディスペンサー — SolderShot —

- ・ソルダーペースト、銀ペーストなどの
微小塗布に最適
- ・独自の構造により、柔らかい粒子が
つぶれにくい
- ・最小塗布径100 μm 以下



概要

■ピエゾアクチュエーターによる、容積押し出し型ディスペンサー
中粘度から高粘度樹脂の塗布用途

特長

- 最小塗布径100 μm 以下。 クリームハンダ塗布径200 μm 以下
- シンプルな構造のため分解、洗浄が行いやすい
- 独自の構造によりハンダなど柔らかい粒子がつぶれにくい

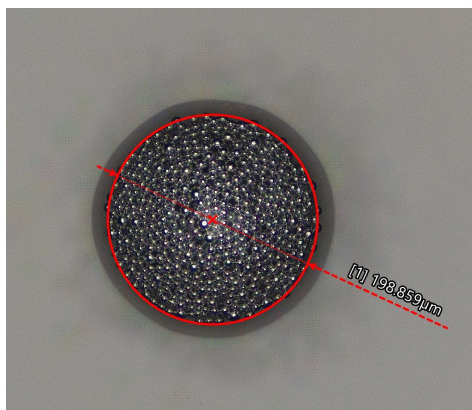
ノズルラインナップ

- 内径50、75、100、150、250、300、400 μm
内径25 μm や、撥液コーティングなどの特注対応可

用途例

- ソルダーペースト、銀ペースト、レジスト剤、UV硬化型樹脂の塗布

クリームハンダ 塗布例



径: 約200um
厚み: 約80um

径: 約100um
厚み: 約20um

UV硬化型樹脂 塗布例

